

(비공식 번역본)

투자위원회 고시

제Sor.6/2564호

반도체 산업에 대한 투자 촉진 개정사항

투자 촉진 정책과 기준에 관한 2014년 12월 3일자 투자위원회 고시 제2/2557호의 내용과 관련하여, 투자위원회는 불기 2520년(1977년) 투자유치법 제15항과 제31/1항에 의거하여 다음의 내용을 고시하는 바이다.

1. 2014년 12월 3일자 투자위원회 고시 제2/2557호에 첨부된 촉진 활동 항목에서 5.4.9, 5.4.12 및 5.4.14의 활동들은 폐지하며 아래의 활동들로 대체하는 것으로 촉진활동을 수정한다.

활동	조건	인센티브
5.4.9 웨이퍼 그라인딩, 쏘잉된 다이스(sawed dice), 웨이퍼 테스트, IC 테스트, IC 모듈 등과 같은 다운스트림 제품 또는 제조 공정 사이에서 얻어지는 제품을 포함하는 반도체 및/또는 반도체 부품 제조	집적회로(IC) 생산의 경우, 기존 기계의 개조(refurbishment)비용은 투자로 간주되어 법인세 면제 한도 계산 시 고려되며, 기존 기계의 취득가액은 투자로 간주되지 않는다.	A2
5.4.9.1 웨이퍼 그라인딩, 쏘잉된 다이스(sawed dice), 웨이퍼 테스트, IC 테스트 IC 모듈 등과 같은 다운스트림 제품 또는 제조 공정 사이에서 얻어지는 제품을 포함하여 대규모로 투자한 반도체 및/또는 반도체 부품 제조	제조 공정에 사용되는 기계(설치비 및 테스트 비용 포함)의 투자 금액은 15억 바트 이상이어야 한다.	
5.4.9.2 웨이퍼 그라인딩, 쏘잉된 다이스(sawed dice), 웨이퍼 테스트, IC 테스트 IC 모듈 등과 같은 다운스트림 제품 또는 제조 공정 사이에서 얻어지는 제품을 포함하는 반도체 및/또는 반도체 부품 제조		

활동	조건	인센티브
5.4.12 유연 인쇄회로기판 및/또는 인쇄회로기판 및/또는 부품의 제조	제조 공정은 위원회의 승인을 받아야 한다.	
5.4.12.1 대규모투자한유연인쇄회로기판 및/또는 다층 인쇄회로기판 및 /또는 부품의 제조	제조 공정에 사용되는 기계(설치비 및 테스트 비용 포함)의 투자 금액은 15억 바트 이상이어야 한다.	A2
5.4.12.2 유연 인쇄회로기판 및/또는 다층 인쇄회로기판 및/또는 부품의 제조		A3
5.4.12.3 기타 인쇄회로기판 및/또는 부품의 제조		B1
5.4.14 인쇄회로기판조립(PCBA) 또는 동일 프로젝트에서 PCBA의 다운스트림 제품의 제조	PCBA의 전체 조립 공정은 동일 프로젝트에서 표면실장기술(SMT: Surface Mount Technology)을 사용해야 한다.	
5.4.14.1 대규모로 투자한 PCBA 또는 동일 프로젝트에서 PCBA의 다운스트림 제 품의 제조	제조 공정에 사용되는 기계(설치비 및 테스트 비용 포함)의 투자 금액은 5억 바트 이상이어야 한다	A3
5.4.14.2 PCBA 또는 동일 프로젝트에서 PCBA 다운스트림 제품의 제조		A4

2. 첨단 기술과 혁신을 활용하는 활동에서 잠재력을 높이고 국가 경쟁력을 개발하기 위해 2014년 12월 3일자 투자위원회 고시 제2/2557호에 첨부된 5.5.1의 활동은 폐지하며 다음의 내용으로 대체·수정한다.

활동	조건	인센티브
5.5.1 웨이퍼의 제조	제조 공정은 위원회의 승인을 받아야 한다.	10년 동안 한도 없이 법인세 면제

3. 본 개정사항은 이 고시의 발표일부터 제출된 촉진 신청서와 이 고시 발표 전까지 승인되지 않은 촉진 신청서에 대해 효력을 발생한다.

이 고시는 지금부터 유효하다.

고시일 2021년 9월 16일

쁘라윛 찐오차 장군(General Prayut Chan-o-cha)

(Prayut Chan-o-cha)

총리

투자위원회 의장